

YDS-H9MF-IMX258 V1.0

13MP Sony IMX258 MIPI-Schnittstelle M12 Fester Fokus Kameramodul



Vorderansicht



Rückansicht

Spezifikationen

Kameramodul Nr.	YDS-H9MF-IMX258 V1.0
Auflösung	13MP
Bildsensor	IMX258
Sensorart	1/3.06"
Pixel Größe	1.12 um x 1.12 um
EFL	2.27 mm
F.NO	2.40
Pixel	4224 x 3136
Betrachtungswinkel	152.0°(DFOV) 122.0°(HFOV) 93.0°(VFOV)
Linsenabmessungen	13.00 x 13.00 x 22.82 mm
Modulgröße	60.00 x 22.00 mm
Modultyp	Fester Fokus
Schnittstelle	MIPI
Autofokus-VCM-Treiber-IC	Keiner
Linsenmodell	YDS-LENS-YM6081
Linsentyp	650 nm IR-Schnitt
Betriebstemperatur	-20°C to +70°C
Gegenstecker	AXE540124

YDS-H9MF-IMX258 V1.0

13MP Sony IMX258 MIPI-Schnittstelle M12 Fester Fokus Kameramodul



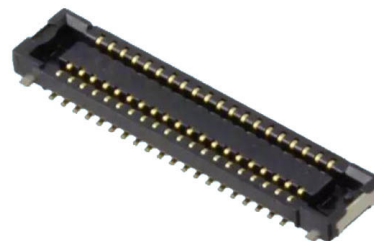
Ansicht von oben



Seitenansicht



Untersicht



Gegenstecker

Version	Information	Date
V1.0	First Version	6-17-2020

RoHS	Signal
1	DGND
2	DGND
3	NC
4	SDA
5	SCL
6	NC
7	NC
8	DGND
9	MCP
10	MCN
11	DGND
12	MDDP
13	MDDN
14	MDTP
15	MDTN
16	DGND
17	NC
18	NC
19	NC
20	NC
21	MD3N
22	MD3P
23	DGND
24	MD2N
25	MD2P
26	NC
27	DGND
28	XCLK
29	DGND
30	AGND
31	AVDD.2.8V
32	NC
33	PWDN
34	DOVDD.1.8V
35	DOVDD.1.8V
36	DVDD.1.2V
37	NC
38	NC
39	NC
40	SID

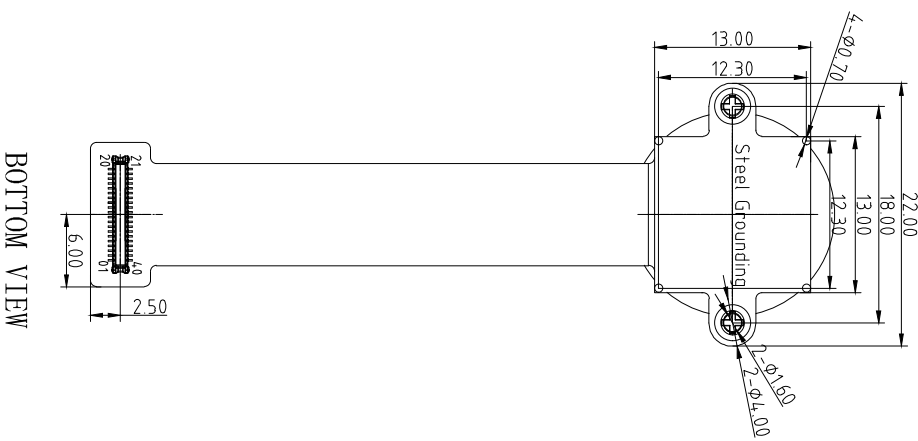
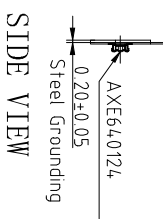
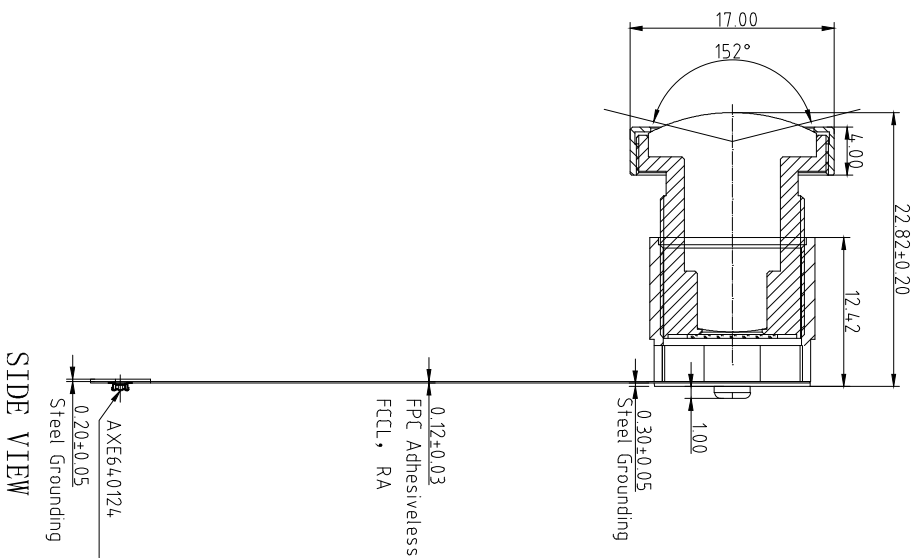
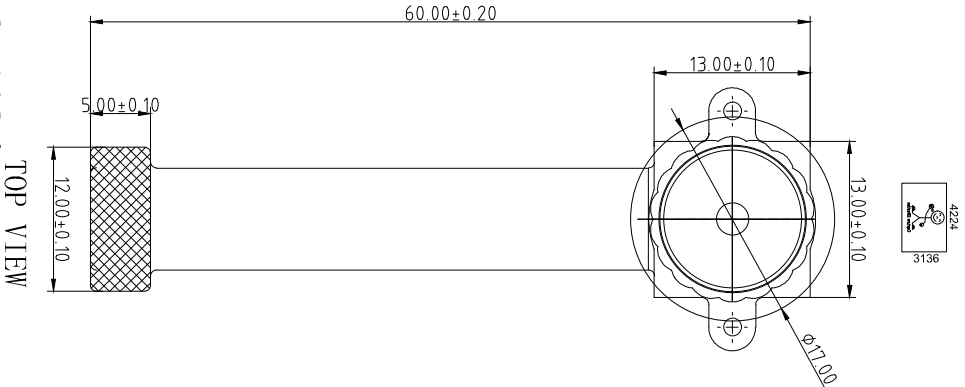
NOTE:
1.Sensor I2C slave address:0x34, If SID=0;
or 0x20 If SID=1

Parameters:

Sensor Specification
Image Sensor:IMX258
Pixel: 1.12umx1.12um
Lens Type: 1/3.06"
Important Voltage Description:
DVDD:1.2V DOVDD:1.8V
AVDD:2.8V

2. Lens specification:

FOV: 152°(D), 122°(H), 93°(V)
F/NO: 2.4
TV distortion: <-15%
Focal length: 2.27mm
Composition: 6G+IR FILTER
IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%



BOTTOM VIEW

A

B

C

D

E

3

3

2

2

1

1

[Product Brief]

Ver.1.0

IMX258

Diagonal 5.867 mm (Type 1/3.06) 13Mega-Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

Description

IMX258 is a diagonal 5.867mm (Type 1/3.06) 13 Mega-pixel CMOS active pixel type stacked image sensor with a square pixel array. It adopts Exmor R^{STM} technology to achieve high speed image capturing by column parallel A/D converter circuits and high sensitivity and low noise image (comparing with conventional CMOS image sensor) through the backside illuminated imaging pixel structure. R, G, and B pigment primary color mosaic filter is employed. By introducing spatially multiplexed exposure technology, high dynamic range still pictures and movies are achievable. It

equips an electronic shutter with variable integration time. It operates with three power supply voltages: analog 2.7 V, digital 1.2 V and 1.8 V for input/output interface and achieves low power consumption.

In addition, this product is designed for use in cellular phone and tablet pc. When using this for another application, Sony does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than cellular phone and tablet pc. Consult your Sony sales representative if you have any questions.

Functions and Features

- ◆ Back-illuminated and stacked CMOS image sensor Exmor R^{STM}
- ◆ Phase Detection pixel data output for Phase Detection Auto Focus
- ◆ High Dynamic Range (HDR) mode with raw data output.
- ◆ High signal to noise ratio (SNR).
- ◆ Full resolution @30fps (Normal / HDR). 4K2K @30fps (Normal / HDR) 1080p @60fps (Normal)
- ◆ Output video format of RAW10/8.
- ◆ Pixel binning readout and V sub-sampling function.
- ◆ Independent flipping and mirroring.
- ◆ CSI-2 serial data output (MIPI 2lane/4lane, Max. 1.3Gbps/lane, D-PHY spec. ver. 1.1 compliant)
- ◆ 2-wire serial communication.
- ◆ Two PLLs for independent clock generation for pixel control and data output interface.
- ◆ Dynamic Defect Pixel Correction.
- ◆ Fast mode transition. (on the fly)
- ◆ Dual sensor synchronization operation.
- ◆ 4K bit of OTP ROM for users.
- ◆ Built-in temperature sensor.

Device Structure

- ◆ CMOS image sensor
- ◆ Image size : Diagonal 5.867 mm (Type 1/3.06)
- ◆ Total number of pixels : 4224 (H) × 3192 (V) approx. 13.48 M pixels
- ◆ Number of effective pixels : 4224 (H) × 3144 (V) approx. 13.28 M pixels
- ◆ Number of active pixels : 4208 (H) × 3120 (V) approx. 13.13 M pixels
- ◆ Chip size : 5.990 mm (H) × 3.908 mm (V)
- ◆ Unit cell size : 1.12 μm (H) × 1.12 μm (V)
- ◆ Substrate material : Silicon

System block diagram



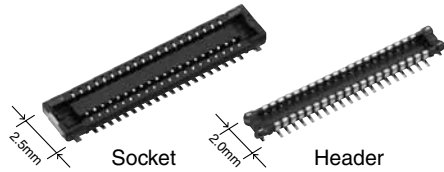
Exmor RS

* Exmor RS is a trademark of Sony Corporation. The Exmor RS is a Sony's CMOS image sensor with high-resolution, high-performance and compact size by replacing a supporting substrate in Exmor R™ which changed fundamental structure of Exmor™ pixel adopted column parallel A/D converter to back-illuminated type, with layered chips formed signal processing circuits.

YDS-LENS-YM6081

No.	ITEM	SPECIFICATION
1	焦距 (FFL)	2.25mm
2	光学后焦 (BFL)	3.73mm (IR 0.21mm)
3	机械后焦 (MFL)	3.2mm (IR 0.21mm)
4	光学总长 (TTL)	22mm (IR 0.21mm)
5	光通 (FNo)	2.6
6	最大像面(Max Image Circle)	Φ5.0
7	光学结构 (Structure)	6G+IR
8	接口(Mount)	M12+P0.5
9	光轴透过率 (Spectral Transmission)	Tavg ≥ 80%
Sensor		
IMX214		
10	视场角 (FOV)	Vertical: 89.1° (φ=1.747)
	Horizontal	120.0° (φ=2.357)
	Diagonal	149.4° (φ=2.934)
11	光学畸变 ("Optical Distortion")	-54.3%
12	相对亮度 (Relative IL)	55.0%
13	主光线角度 (CRA)	29.7°
14	IR FILTER SPEC.(Built-in/Others available)	Tavg ≥ 85% @ 425-650 nm T=50% @ 670/410 nm Tavg < 3% @ 700-1000 nm T < 5% @ 1050 nm

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计		20210427	标准化		
审核			批准		
工艺					
阶段标记			重量	比例	
共 张			第 张	4:1	



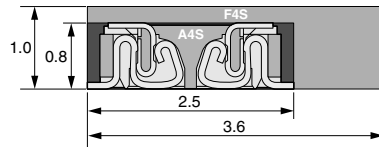
RoHS compliant

FEATURES

1. 2.5 mm wide slim two-piece style connectors

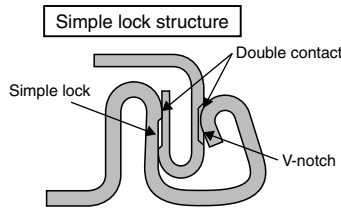
Compact and slim structure contributes overall miniaturization of product design. <Compared to F4S series (40 pin contacts, when mated)>

- Width: 30% down
- Footprint: 30% down



2. **"TOUGH CONTACT ADVANCED"** ensures high resistance to various environments in lieu of slim and low profile body

3. Simple lock structure provides tactile feedback to ensure excellent mating/unmating operation feel.



The connector gives the tactile feedback when inserted, allowing reliable mating.

- 4. Mated heights of 0.8 and 1.0 mm are available for the same foot pattern.
- 5. Connectors for inspection available

APPLICATIONS

Recommended for board-to-FPC connections of mobile equipment, such as cellular phones, smart phones, laptops, and portable music players

ORDERING INFORMATION

	AXE				2	4
5: Narrow Pitch Connector A4S (0.4 mm pitch) Socket						
6: Narrow Pitch Connector A4S (0.4 mm pitch) Header						
Number of pins (2 digits)						
Mated height						
<Socket>						
1: For mated height 0.8/1.0 mm						
<Header>						
1: For mated height 0.8 mm						
2: For mated height 1.0 mm						
Functions						
2: Without positioning bosses						
Surface treatment (Contact portion / Terminal portion)						
<Socket>						
4: Ni plating on base, Au plating on surface (for Ni barrier available)						
<Header>						
4: Ni plating on base, Au plating on surface						

PRODUCT TYPES

Mated height	Number of pins	Part number		Packing		
		Socket	Header	Inner carton (1-reel)	Outer carton	
0.8mm	10	AXE510124	AXE610124	5,000 pieces	10,000 pieces	
	12	AXE512124	AXE612124			
	14	AXE514124	AXE614124			
	16	AXE516124	AXE616124			
	18	AXE518124	AXE618124			
	20	AXE520124	AXE620124			
	22	AXE522124	AXE622124			
	24	AXE524124	AXE624124			
	26	AXE526124	AXE626124			
	28	AXE528124	AXE628124			
	30	AXE530124	AXE630124			
	32	AXE532124	AXE632124			
	34	AXE534124	AXE634124			
	36	AXE536124	AXE636124			
	38	AXE538124	AXE638124			
	40	AXE540124	AXE640124			
	44	AXE544124	AXE644124			
	50	AXE550124	AXE650124			
	1.0mm	54	AXE554124			AXE654124
		56	AXE556124			AXE656124
60		AXE560124	AXE660124			
64		AXE564124	AXE664124			
70		AXE570124	AXE670124			
80		AXE580124	AXE680124			
10		AXE510124	AXE610224			
12		AXE512124	AXE612224			
14		AXE514124	AXE614224			
20		AXE520124	AXE620224			
24		AXE524124	AXE624224			
26		AXE526124	AXE626224			
30		AXE530124	AXE630224			
32		AXE532124	AXE632224			
40	AXE540124	AXE640224				
44	AXE544124	AXE644224				
50	AXE550124	AXE650224				
54	AXE554124	AXE654224				
60	AXE560124	AXE660224				
70	AXE570124	AXE670224				
80	AXE580124	AXE680224				

Notes: 1. Order unit:

For volume production: 1-inner carton (1-reel) units

Samples for mounting check: 50-connector units. Please contact our sales office.

Samples: Small lot orders are possible. Please contact our sales office.

- The above part numbers are for connectors without positioning bosses, which are standard. When ordering connectors with positioning bosses, please contact our sales office.
- Please contact us for connectors having a number of pins other than those listed above.

AXE5, 6

SPECIFICATIONS

■ Characteristics

	Item	Specifications	Conditions
Electrical characteristics	Rated current	0.3A/pin contact (Max. 5 A at total pin contacts)	
	Rated voltage	60V AC/DC	
	Breakdown voltage	150V AC for 1 min.	No short-circuiting or damage at a detection current of 1 mA when the specified voltage is applied for one minute.
	Insulation resistance	Min. 1,000MΩ (initial)	Using 250V DC megger (applied for 1 min.)
	Contact resistance	Max. 90mΩ	Based on the contact resistance measurement method specified by JIS C 5402.
Mechanical characteristics	Composite insertion force	Max. 1.200N/pin contacts × pin contacts (initial)	
	Composite removal force	Min. 0.165N/pin contacts × pin contacts	
	Contact holding force (Socket contact)	Min. 0.20N/pin contacts	Measuring the maximum force. As the contact is axially pull out.
Environmental characteristics	Ambient temperature	-55°C to +85°C	No freezing at low temperatures. No dew condensation.
	Soldering heat resistance	Peak temperature: 260°C or less (on the surface of the PC board around the connector terminals)	Infrared reflow soldering
		300°C within 5 sec. 350°C within 3 sec.	Soldering iron
	Storage temperature	-55°C to +85°C (product only) -40°C to +50°C (emboss packing)	No freezing at low temperatures. No dew condensation.
	Thermal shock resistance (header and socket mated)	5 cycles, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Sequence 1. -55 ^{±3} °C, 30 minutes 2. ~, Max. 5 minutes 3. 85 ^{±3} °C, 30 minutes 4. ~, Max. 5 minutes
	Humidity resistance (header and socket mated)	120 hours, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 40±2°C, humidity 90 to 95% R.H.
	Saltwater spray resistance (header and socket mated)	24 hours, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 35±2°C, saltwater concentration 5±1%
H ₂ S resistance (header and socket mated)	48 hours, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 40±2°C, gas concentration 3±1 ppm, humidity 75 to 80% R.H.	
Lifetime characteristics	Insertion and removal life	30 times	Repeated insertion and removal speed of max. 200 times/hours
Unit weight		20 pin contact type: Socket: 0.02 g Header: 0.01 g	

■ Material and surface treatment

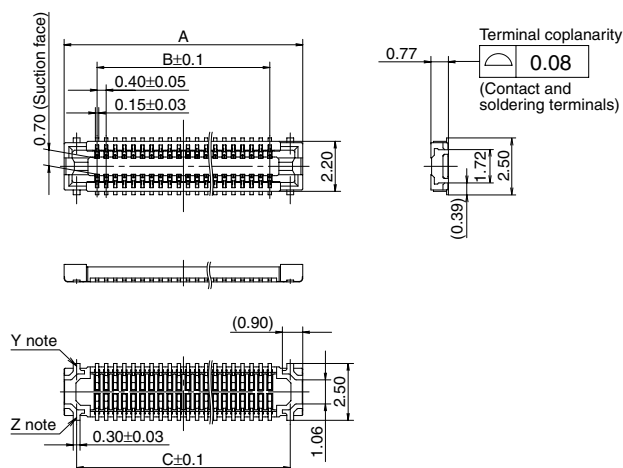
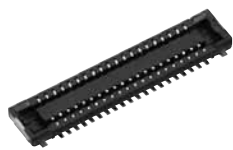
Part name	Material	Surface treatment
Molded portion	LCP resin (UL94V-0)	—
Contact and Post	Copper alloy	Contact portion: Base: Ni plating Surface: Au plating Terminal portion: Base: Ni plating Surface: Au plating (except the terminal tips) The socket terminals close to the portion to be soldered have nickel barriers (exposed nickel portions). Soldering terminals: Sockets: Base: Ni plating Surface: Pd+Au flash plating (except the terminal tips) Headers: Base: Ni plating Surface: Au plating (except the terminal tips)

DIMENSIONS (Unit: mm)

The CAD data of the products with a **CAD Data** mark can be downloaded from: <http://industrial.panasonic.com/ac/e>

■ **Socket (Mated height: 0.8 mm/1.0 mm)**

CAD Data



General tolerance: ±0.2

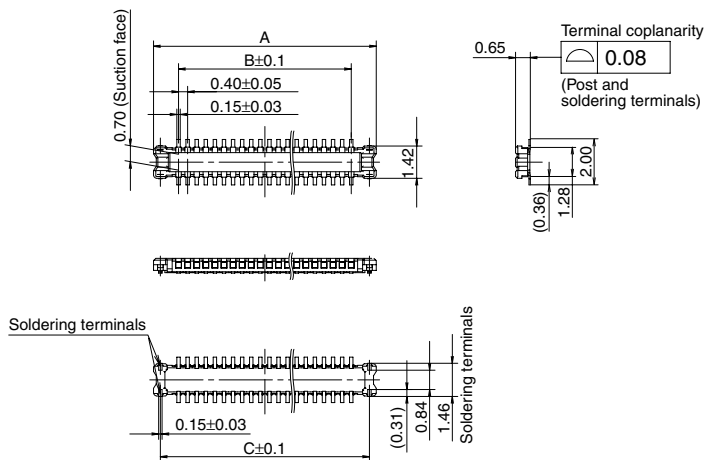
Note: Since the soldering terminals has a single-piece construction, sections Y and Z are electrically connected.

Dimension table (mm)

Number of pins/dimension	A	B	C
10	4.5	1.6	3.4
12	4.9	2.0	3.8
14	5.3	2.4	4.2
16	5.7	2.8	4.6
18	6.1	3.2	5.0
20	6.5	3.6	5.4
22	6.9	4.0	5.8
24	7.3	4.4	6.2
26	7.7	4.8	6.6
28	8.1	5.2	7.0
30	8.5	5.6	7.4
32	8.9	6.0	7.8
34	9.3	6.4	8.2
36	9.7	6.8	8.6
38	10.1	7.2	9.0
40	10.5	7.6	9.4
44	11.3	8.4	10.2
50	12.5	9.6	11.4
54	13.3	10.4	12.2
56	13.7	10.8	12.6
60	14.5	11.6	13.4
64	15.3	12.4	14.2
70	16.5	13.6	15.4
80	18.5	15.6	17.4

■ **Header (Mated height: 0.8 mm)**

CAD Data



General tolerance: ±0.2

Dimension table (mm)

Number of pins/dimension	A	B	C
10	3.8	1.6	3.2
12	4.2	2.0	3.6
14	4.6	2.4	4.0
16	5.0	2.8	4.4
18	5.4	3.2	4.8
20	5.8	3.6	5.2
22	6.2	4.0	5.6
24	6.6	4.4	6.0
26	7.0	4.8	6.4
28	7.4	5.2	6.8
30	7.8	5.6	7.2
32	8.2	6.0	7.6
34	8.6	6.4	8.0
36	9.0	6.8	8.4
38	9.4	7.2	8.8
40	9.8	7.6	9.2
44	10.6	8.4	10.0
50	11.8	9.6	11.2
54	12.6	10.4	12.0
56	13.0	10.8	12.4
60	13.8	11.6	13.2
64	14.6	12.4	14.0
70	15.8	13.6	15.2
80	17.8	15.6	17.2

Kameraanwendungen



Autopilot



Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung



Maschinelles Sehen



Agrarmonitor



Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adleraugen



Interaktive Haustierkamera

Referenztable für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren	
Pin Signal	Beschreibung
DGND GND	Masse für digitale Schaltung
AGND	Masse für analoge Schaltung
PCLK DCK	DVP-PCLK-Ausgang
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand
MCLK XVCLK XCLK INCK	Systemeingangsuhr
RESET RST	Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen
NC NULL	keine Verbindung
SDA SIO_D SIOD	SCCB-Daten
SCL SIO_C SOIC	SCCB-Eingangstakt
VSYNC XVS FSYNC	DVP-VSYNC-Ausgang
HREF XHS	DVP-HREF-Ausgang
DOVDD	Strom für E/A-Schaltung
AFVDD	Strom für VCM-Schaltung
AVDD	Strom für analoge Schaltung
DVDD	Strom für digitale Schaltung
STROBE FSTROBE	Strobe-Ausgang
FSIN	Synchronisieren Sie das VSYNC-Signal vom anderen Sensor
SID	SCCB letzte Bit-ID-Eingabe
ILPWM	mechanische Shutter-Ausgangsanzeige
FREX	Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO	Allzweckeingänge
SLASEL	I2C-Slave-Adresse auswählen
AFEN	CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC
MIPI Schnittstelle	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI Uhr negativer Ausgang
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI Takt positiver Ausgang
DVP Parallel Schnittstelle	
D0 DO0 Y0	DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1	DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2	DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3	DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4	DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5	DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6	DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7	DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8	DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9	DVP Datenausgabeport 9
D10 DO10 Y10	DVP Datenausgabeport 10
D11 DO11 Y11	DVP Datenausgabeport 11

Kamera-Zuverlässigkeitstest

Zuverlässigkeitsprüfpunkt		Testmethode	Akzeptanzkriterium	
Kategorie	Artikel			
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig



Kamerainspektionsstandard

Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard	
Kategorie	Artikel			
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel
Farbauflösung			Das bloße Auge	Kein Problem
Abmessungen	Höhe	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Breite	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Länge	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Gesamt	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	

YDSCAM Paketlösungen

YDSCAM Kameramodul



Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum



Legen Sie die Kameras auf das Tablett



YDSCAM Paketlösungen

Volles Fach mit Kameras



Decken Sie das Tablett mit dem Deckel ab



Legen Sie das Tablett in den antistatischen Beutel



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel



YDSCAM Paketlösungen

Versiegelter antistatischer Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Herstellungsdatumscode 4. Achtung



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie Schaumstoffplatten zwischen die Tablettbeutel



Schaumstoffplatten sind größer als Tablett



Legen Sie Schaumstoffplatten und Tablett in den Karton



Die Schaumstoffplatten sitzen fest im Karton



Verschließen Sie die Carbon Box



Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

USB-Kameramodul

Komplett mit Objektivschutzfolie



Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel

Legen Sie USB-Kameras in das Fach



Verschließen Sie das Tablett mit einem antistatischen Beutel

Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel



Legen Sie die Steckverbinder in den antistatischen Beutel



Beschriften Sie die Probenbeutel



Stecken Sie die Steckverbinder in die Spule



Legen Sie Proben in die Carbonbox



Stecken Sie die Steckverbinder in die Carbonbox



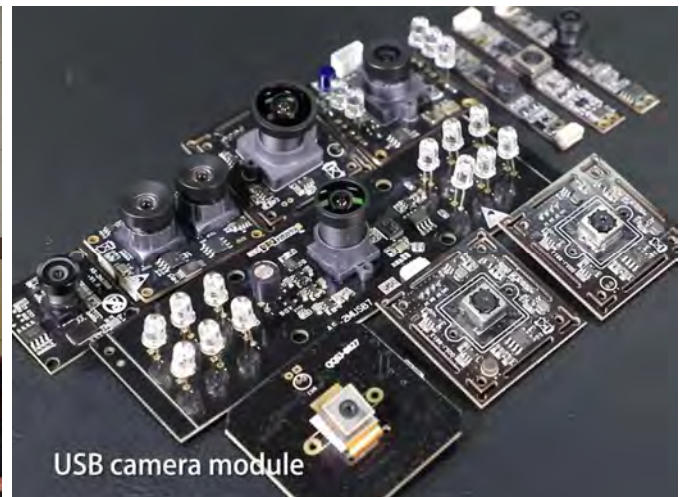


Firma YDSCAM

YingDeShun Co. Ltd. (YDS) wurde 2017 gegründet, ein technologieorientierter Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. YDS verfügt über 20.000 Quadratmeter große automatisierte Anlagen mit 100 Mitarbeitern und einem Jahresdurchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

YDS bietet OEM- und ODM-Design sowie Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen mitteilen, sogar mit einem Handentwurf. Unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. YDS ist auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektroniktechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign spezialisiert. Unsere erfahrenen strategischen Liefersysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.



Eingeschränkte Garantie

YDS gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der YDS-Firma oder über die YDS-Website www.YDSCAM.com erworben haben. Von anderen Verkäufern oder Quellen gekaufte Produkte fallen nicht unter diese eingeschränkte Garantie. YDS garantiert, dass die Produkte bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanzzeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während der Garanzzeit wesentliche Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen oder entwickeln, wird YDS nach eigenem Ermessen entweder: (i) das/die Produkt(e) reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein/e neue oder generalüberholte(n) Produkt(e) ersetzen (wobei das/die Ersatzprodukt(e) vom identischen Modell oder einer gleichwertigen Funktion sein müssen); oder (iii) Ihnen eine Rückerstattung des Preises gewähren, den Sie für das/die Produkt(e) bezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von YDS beschränkt sich ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz gemäß den oben dargelegten Bedingungen. YDS ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für etwaige Folgeereignisse.





YDS CAMERA MODULE

your best camera partner

Unsere Unternehmensstärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service



Versprochene Lieferung



www.YDSCAM.com sales@ydscam.com Phone (WeChat, QQ): (+86) 177 2732 6718

All rights reserved @ YingDeShun Co. Ltd. Specifications subject to change without notice.